

南臺科技大學 107 學年度第 2 學期課程資訊

課程代碼	30D1BZ02
課程中文名稱	電子元件拆鋸實務
課程英文名稱	Electronic Components unsoldering/soldering Practice
學分數	1.0
必選修	必修
開課班級	四技系統二乙
任課教師	謝文哲
上課教室(時間)	週二第 6 節(J405) 週二第 7 節(J405) 週二第 8 節(J405)
課程時數	3
實習時數	3
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	TEMI 電子元件拆鋸能力認證實用級
輔導考照 2	TEMI 電子元件拆鋸能力認證專業級
課程概述	培養學生電子元件識別、拆鋸工具特性與使用及電路板元件拆鋸與佈線等相關知識及技術，具備業界實用之實務技能。
先修科目或預備能力	數位邏輯設計、數位系統設計、電路學
課程學習目標與核心能力之對應	<p>※編號，中文課程學習目標，英文課程學習目標，對應系指標</p> <p>-----</p> <p>1.熟悉電子元件拆鋸工具的使用。 ，--，1 專業技能</p> <p>2.能使用拆鋸工具電路板電子元件的拆除與重新銲接。 ，--，2 工程實務</p> <p>3.熟練電路板拆鋸、佈線設計與檢修等技能，以具備產業界實用之實務能力。 ，--，5 終身學習</p> <p>4.透過電路佈線設計、電子元件拆鋸等實作過程，培養學生抗壓力。 ，--，6 熱誠抗壓</p>
中文課程大綱	<ol style="list-style-type: none"> 1.拆鋸工具功能介紹 2.電子元件識別 3.電子元件拆鋸 4.電子元件銲接 5.電路的佈線設計與銲接 6.電路的功能測試 7.電路的故障分析與檢修

英/日文課程大綱	1.Introduction of unsoldering Tools. 2.Electronic Components identifying. 3.Electronic Components unsoldering. 4.Electronic Components soldering. 5.Circuit Layout Design and soldering. 6.Function Testing. 7.Fault Analysis and Repairing
課程進度表	1.拆錫工具功能介紹(1 週) 2.電子元件識別(1 週) 3.電子元件拆錫(2 週) 4.電子元件銲接(3 週) 5.期中測驗 6.電路的佈線設計與銲接(3 週) 7.電路的功能測試(3 週) 8.電路的故障分析與檢修(3 週) 9.期末測驗
教學方式與評量方法	※課程學習目標，教學方式，評量方式 ----- 熟悉電子元件拆錫工具的使用。 ，實作演練，實作 能使用拆錫工具電路板電子元件的拆除與重新銲接。 ，實作演練，實作 熟練電路板拆錫、佈線設計與檢修等技能，以具備產業界實用之實務能力。 ，實作演練，實作 透過電路佈線設計、電子元件拆錫等實作過程，培養學生抗壓力。 ，實作演練，實作
指定用書	書名： 作者： 書局： 年份： ISBN： 版本：
參考書籍	1.TEMI 電子元件拆與銲能力認證實用級術科題目。 2.電子元件拆與銲能力認證專業級術科題目。 3.2013 數位邏輯設計實用級暨專業級認證術科題本。
教學軟體	
課程規範	1.上課須自備銲接材料與工具。

	2.實作過程因使用烙鐵,請注意安全以避免燙傷等傷害.
--	----------------------------